◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-82531

⑤Int.Cl.⁵	識別記号	庁内整理番号	43公開	平成 2年(1990) 3月23日
H 01 L 21/3205 G 12 B 17/02 H 01 L 21/90 29/40 H 05 K 1/02 9/00	V Z P F R	6947-2F 6824-5F 7638-5F 8727-5E 7039-5E 7039-5E 6824-5F H 0 審査請才	– .	S 情求項の数 1 (全3頁)

69発明の名称 半導体装置

> 願 昭63-235511 21)特

願 昭63(1988)9月19日 29出

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 奥村 孝一郎 @発 明 者

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社 勿出 願 人

弁理士 内 原 個代 理 人

1. 発明の名称 半導体装置

2. 特許請求の範囲

微小信号線の少なくとも上方と下方に絶縁膜を 介して定電位の雑音遮蔽用電極を設けたことを特 徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体装置に関し、特に半導体技術 の敬細化、多層配線化に適した雑音遮蔽用電極を 設けた半導体装置に関する.

[従来の技術]

従来、微小信号の伝播する信号配線、例えばア ナログ・デジタル変換回路のアナログ部や高速メ モリー回路のセンスアンプ部においては、外来の 雑音あるいは、他の信号配線との容量結合、電磁

結合による雑音の影響を避けるために、第4図の ように微小信号の配線1と他の信号配線1′を交 差せず、十分な距離をとって配置するか、又は、 第5図に示すように、微小信号線1の絶縁膜を介 して上方にのみ接地された別の金属電極2を、微 小信号線1の大部分を覆うように配置していた。 [発明が解決しようとする課題]

上述した従来の雑音遮蔽あるいは回避技術にお いては、半導体技術の進歩により微細化、多層配 線化が進行するに伴って微小信号配線の近隣には、 他の信号配線を配置できない為無駄領域が生じ、 また信号線のレイアウト設計時に、微小信号配線 と通常の信号配線を常に念頭におき、互いの交差 が生じないようにしなければならない為、レイア ウトの複雑さを増大させる要因となってきた。 例 まば第4図の従来例においては、微小信号配線1 の上下に他の信号配線を配置することができない のはもちろんのことであるが、左右方向において も、相互の容量結合による雑音の発生を防止する ために、微小配線1と他の信号配線1′の距離を

狭めることができず、微細化の障害となる欠点があり、また第5 図の従来例においては、電気機器のオン・オフの時に発生する雑音等の外来雑音の遮蔽を目的を目的としているため、微小信号線1 の下方に配置された信号線からの雑音には無対策であるという欠点があった。

[課題を解決するための手段]

本発明の半導体装置は、微小信号配線の上下に、 遮蔽電極を設ける、あるいは微小信号配線の上下 及び両側面に遮蔽電極を設ける、あるいは、微小 信号配線の周囲を囲むように遮蔽電極を設けると いう特徴を有している。

したがって、外来の雜音はもとより、他の信号 配線との容量結合、電磁結合により生じる雑音を より効果的に遮蔽することができる。

〔寒施例〕

第1図(a)は、第1の実施例の平面図である。 数小信号配線1は接地された第1の遮蔽用電極2 により上面方向からの雑音より遮蔽され、また接 地された第2の遮蔽用電極3により下面方向から

ことにより、第1図(b)より更に効果的に横方向からの雑音の影響を遮蔽することができる。

第3図は本発明の第3の実施例を示す断面図である。本実施例においては第2図の実施例の上面の遮蔽用電極20及び側面の遮蔽用電極20及び側面の遮蔽用電極20及び側面の遮蔽用電極20と下面の遮蔽用電極3との間にそれぞれスルーホール30及び31を設けることにより、ほぼ完全に微小信号配線1を外来および周囲の信号配線に起因する雑音から遮蔽することができる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明は、微小信号配線 を、その上下に又は上下と側面に、又は周囲を囲むように定電位の遮蔽用電極を設置することにより、微小信号線への雑音を遮蔽する効果がある。 第1の実施例の場合は、横方向から洩れる雑音の 遮蔽効果は十分でないが比較的小占有面積で実現できるため、微小信号でも比較的振幅が大きで 全な雑音遮蔽を要しない部分に用いる効果が大で あり、第3の実施例の場合は占有面積は大きくな の雑音より遮蔽される。第1 図(b) は第1 の実施例の第1 図(a)においてAーA′で切断した時の断面図である。第1 図(c) は、第1 図(a)の平面図でAーA′に沿って微小信号線1の上下で他の信号線を交差して配置した時のAーA′に沿った他面図を示したものである。微小信号線1 は上面を接地された第1 の遮蔽用電極 2 により 覆われて を地された第2 の遮蔽用電極 3 により 覆われて の 造 を 2 により である。 8 および 9 からの雑音の大部分は遮蔽れて 微小信号線1 には達しない。

本実施例においては、横方向からの雑音の遮蔽 は十分ではないが、比較的小面積の使用で上下方 向からの雑音に対しては効果的に遮蔽できる。

第2図は本発明の第2の実施例を示す断面図である。第2の実施例においては、微小信号線1の上部に第1の遮蔽用電極2を配置し、また下部に第2の遮蔽用電極3を配置する点では第1の実施例と同様であるが、それに加えて、微小信号線1の両側方にも遮蔽用電極20をそれぞれ設置する

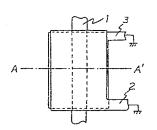
るが、特に信号振幅が小さく、完全な雑音遮蔽を 要する部分に用いるに適している。第2の実施例 の雑音遮蔽能力と占有面積は上記両者の中間であ る。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の第1の実施例の平面図、第1図(b)は本発明の第1の実施例の断面図、第1図(c)は本発明の第1の実施例で、他の信号配線と交差した場合の断面図、第2図は本発明の第2の実施例の断面図、第3図は本発明の第3の実施例の断面図、第4図は従来の信号線との結合に起因する雑音の回避策、第5図は従来の外来雑音の遮蔽策を示す平面図である。

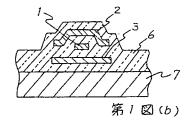
1……微小信号金属配線、1′,8,9……通常 振幅の信号金属配線、2,3,20……遮蔽用金属 電極、6……絶縁膜、7……半導体基板、30, 31……スルーホール。

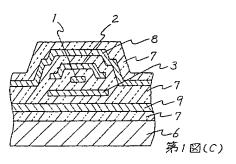
代理人 弁理士 内 原 晋

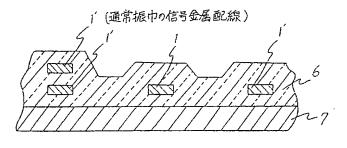


- 1: 做小信号金器配線
- 2: 進蔽用金属電極 3: 遮蔽用金属電極

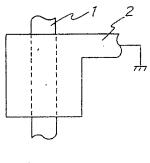
第1四(a)



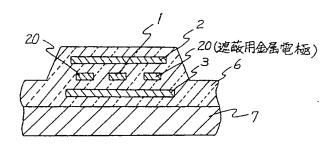




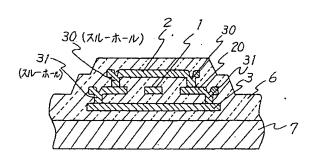
第4 図



第5 図



第2 図



第3 図

THIS PAGE BLANK (USPTO)